



## 6F06【千葉】半導体デバイス製造装置の営業（BONDER DISPENSER）

TDK株式会社での募集です。法人営業（その他）のご経験のある方は歓迎です。

### Job Information

**Recruiter**

JAC Recruitment Co., Ltd.

**Hiring Company**

TDK株式会社

**Job ID**

1581044

**Industry**

Electronics, Semiconductor

**Job Type**

Permanent Full-time

**Location**

Chiba Prefecture

**Salary**

7 million yen ~ 8.5 million yen

**Work Hours**

08:30 ~ 17:15

**Holidays**

【有給休暇】入社7ヶ月目には最低10日以上 【休日】完全週休二日制 土 日 祝日 GW 夏季休暇 年末年始

**Refreshed**

March 5th, 2026 16:06

### General Requirements

**Career Level**

Mid Career

**Minimum English Level**

Business Level

**Minimum Japanese Level**

Native

**Minimum Education Level**

Bachelor's Degree

**Visa Status**

Permission to work in Japan required

### Job Description

【求人No NJB2278040】

**■ミッション：**

FAソリューションズBGの営業部は顧客ニーズを踏まえた最適の製品提案及びアフターサポートを提供をミッションとしています。

その中で半導体デバイス製造装置（BONDER DISPENSER）の販売をしていただきます。

**■職務内容**

- ・新規顧客および既存顧客からの案件サポート
- ・海外現地営業および海外販売代理店を通じた案件サポート

\*ご入社後は、まず販売設備を理解することから業務をお任せし、将来的にはトータル的な企画やマネジメント業務をお任

せします。

\*仕事内容の変更範囲：会社の定める業務全般

※ボンディングマシン：接着加工（ボンディング）を行う精密装置

※ディスペンサー：液体材料を精密に定量吐出するための機器

参考URL：

[https://www.tdk.com/ja/tech\\_mag/illustrated/021](https://www.tdk.com/ja/tech_mag/illustrated/021)

[https://www.tdk.com/ja/tech\\_mag/hatena/050](https://www.tdk.com/ja/tech_mag/hatena/050)

[https://product.tdk.com/system/files/dam/doc/content/event/nepcpn2018/nepcon2018\\_MDM50\\_A1\\_0110\\_ol.pdf](https://product.tdk.com/system/files/dam/doc/content/event/nepcpn2018/nepcon2018_MDM50_A1_0110_ol.pdf)

働き方

- ・残業時間：月15時間程度
- ・在宅勤務頻度：週2回程度
- ・フレックスタイムの有無：あり
- ・出張頻度／期間／行先（国内外）：不定期／数日間／秋田（工場）や各国内外顧客

組織構成

課長1人、課員3人、派遣1人（新卒2、中途3、20代、30代、40代、50代、60代1名ずつ）

■当業務の魅力点・応募者へのメッセージ

伸びしろのある半導体業界の一旦を担う製造措置販売ということから、国内外の大手顧客と直接会話により自らのスキルアップと共に働き甲斐を感じることが出来る業務です。

■魅力ある社風

社員数10万3千人、海外の連結子会社は100社を超える大手企業ながら、前職での経験を考慮した評価制度が存在するため個人の実力が適切に評価される体制が整っており、中途入社後に部門のリーダーを担っている方も多く存在します。勤続年数や経験に問わず手を挙げた方にチャンスがあるのは、東京工業大学発のベンチャー企業ならではの魅力です。

---

## Required Skills

■必須条件：

- ・半導体製造関連業務の実務経験（目安3年以上）
- ・英語力：顧客への設備説明が可能なレベル（目安：TOEIC 600/CEFR B1）、顧客交渉等の場において使用いただきます。

---

## Company Description

■受動部品・セラミックコンデンサ、インダクティブデバイス、高周波部品、圧電材料部品、回路保護部品、アルミ電解コンデンサ、フィルムコンデンサ■センサ応用製品・温度センサ、圧力センサ、磁気センサ、MEMSセンサ■磁気応用製品・マグネット、高性能磁気ヘッド、HDDヘッド用サスペンション■エナジー応用製品・エナジーデバイス、電源（産業機器用、xEV向け車載用など）■その他・フラッシュメモリ応用デバイス、電波暗室、FA機器